

## 技術詞彙表

「AGV」	指	自動導引車
「AI」	指	人工智能
「AI/ML」	指	AI驅動的機器學習
「AMR」	指	自主移動機器人
「AOI」	指	自動化光學檢測
「APC」	指	先進過程控制
「API」	指	應用程式編程接口
「ASIC」	指	專用集成電路
「ATE」	指	集成電路自動化測試設備
「BOM」	指	物料清單
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CAPA」	指	糾正與預防措施，用於識別、調查及消除產品質量缺陷、不合格項及潛在風險的根本原因
「資本開支」	指	資本支出
「CPO」	指	共封裝光學，一種先進的異構集成技術，將硅光器件及ASIC集成在單一封裝基板上，可滿足下一代數據中心互連的超高帶寬、低延遲及高能效要求
「CRM」	指	客戶關係管理
「CTL」	指	芯片測試線
「數通」	指	數據通信
「DFMEA」	指	設計失效模式及影響分析，工程師用以識別及減輕潛在設計缺陷的流程
「DOF」	指	自由度

## 技術詞彙表

「DTL」	指	晶粒測試線
「EDM」	指	企業數字化製造
「EIC」	指	電子集成電路
「EoL」	指	生產線終端
「企業資源規劃」	指	企業資源規劃
「FAU」	指	光纖陣列單元
「FDC」	指	故障檢測與分類系統
「G」或「Gb」	指	千兆位元，為數位資訊單位，等於十億位元
「GEM」	指	通用設備模型，使自動化製造設備能與工廠主機系統交換數據，以進行遠程監控
「GFA」	指	總建築面積
「GPU」	指	圖形處理單元
「HJT」	指	異質結技術
「IC」	指	集成電路
「IDM」	指	集成器件製造商
「LPCVD」	指	低壓化學氣相沉積，一種利用熱量引發前驅氣體在固體基板上發生反應的工藝
「MEMS」	指	微機電系統
「MES」	指	智能製造執行系統
「MT」	指	機械傳輸
「MTL」	指	模組測試線
「納米」	指	納米，長度單位
「OCS」	指	光路交換

## 技術詞彙表

「OEE」	指	整體設備效率
「OE」	指	光學引擎
「光學I/O」	指	光學輸入／輸出
「OSAT」	指	半導體封裝和測試服務提供商
「PCM」	指	工藝過程控制監測
「PECVD」	指	等離子體增強化學氣相沉積，一種利用等離子體在較低溫度下進行沉積的專門技術
「PE-POLY」	指	等離子體增強多晶硅沉積
「PIC」	指	光子集成電路
「PLM」	指	產品生命週期管理，管理產品從概念、工程設計到製造整個生命週期的過程
「PWB」	指	自研光子引線鍵合
「光伏」	指	光伏，利用表現出光伏效應的半導體材料將光轉換為電的技術
「SDK」	指	軟件開發工具包
「SECS」	指	設備接口協議，用於設備到主機的數據通信
「硅光」	指	硅光器件高精度組裝與測試設備
「SPC」	指	統計過程控制，一種利用統計技術在生產過程中監控質量的製造方法，以確保一致性、效率及高品質產出，同時最大限度地減少缺陷與浪費
「T」或「Tb」	指	太拉位元，為數位資訊單位，等於一萬億位元
「電信」	指	電信

## 技術詞彙表

「TOPCon」	指	穿隧氧化層鈍化接觸，一種先進的光伏電池技術，其在重摻雜多晶矽層與矽晶圓之間使用超薄氧化矽層以提高性能
「微米」	指	微米
「WIP」	指	在製品
「WTL」	指	晶圓測試線
「XBC」	指	擴展背接觸，一種高效光伏電池技術，其中所有電觸點均移至電池背面